



VIA Technologies, Inc.

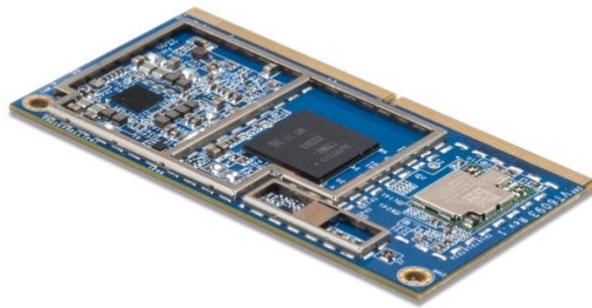
531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E 組み込みプラットフォーム採用 VIA SOM-9X20 モジュール向け Linux BSP の提供を開始 － 次世代 Edge AI システムおよびデバイスの迅速な開発をサポート －

2017 年 6 月 29 日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、台湾時間の 6 月 28 日、VIA SOM-9X20 モジュール向け Yocto 2.0.3 ベースの Linux BSP の提供を開始いたしました。

本 BSP の主な機能は次のとおりです。

- UFS ブート対応
- HDMI ディスプレイをサポート
- USB インタフェースを介して AUO MIPI 容量性タッチパネルをサポート
- AUO 10.1 インチ B101UAN01.7 (1920 × 1200 ピクセル)
- COM をデバッグポートとしてサポート
- 2 つのギガビットイーサネット
- マイク入力とステレオ 2W スピーカーサポート
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.1 対応、ならびに GPS をサポート
- MIPI CSI カメラ OV13850 のサポート



「Linux BSP のリリースにより、Qualcomm® Snapdragon™ 820E 組み込みプラットフォームを搭載したエッジ AI システムおよびデバイスの開発に追加オプションが提供されます」と、VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP リチャード・ブラウンは述べています。「また、VIA はフルセットのシステムハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズサービスを提供し、開発コストを最小限に抑えるとともに市場投入までの時間を短縮します」

Press Release

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E 組み込みプラットフォーム採用 VIA SOM-9X20 モジュール向け Linux BSP の提供を開始

2/2

VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 は、Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォームにより高度集積化されたシステムオンモジュールです。わずか 8.2cm×4.5cm のこのモジュールは、64GB の eMMC フラッシュメモリと 4GB の LPDDR4 SDRAM をオンボードで搭載し、USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0 および USB 2.0 を含む MXM 3.0 314 ピンコネクタを通じて豊富な I/O およびディスプレイ拡張オプションを提供します。また、SDIO、PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI、UART、I2C、SPI、GPIO 用の多機能ピンなどにも対応しています。

VIA SOM-9X20 の詳細については、www.viatech.com/en/boards/modules/som-9x20 をご覧ください。

このリリースに関する画像については、www.viagallery.com/som-9x20/ をご参照ください。

入手性と価格

VIA SOM-9X20 および SOMDB2 キャリアボードは、VIA Embedded オンラインストアにて、569 米ドルで販売されています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

<https://www.viaembeddedstore.com/shop/boards/edge-ai-developer-kit/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス: RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス: press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。